

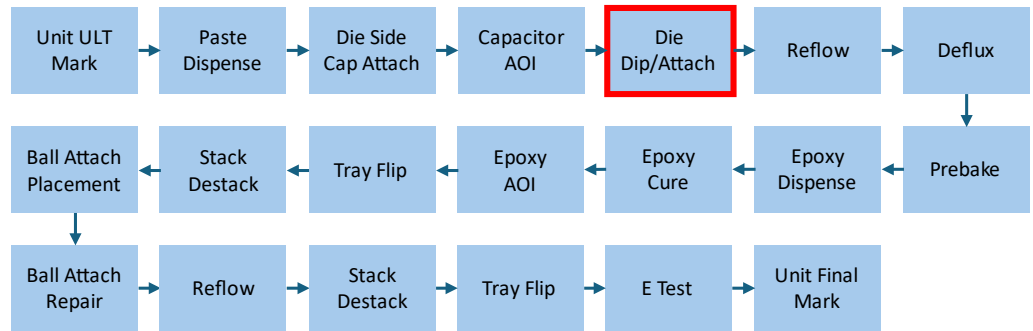
负责 SATAS 发起的研发项目的高精度裸芯片贴装工序的研发

~利用自身的设备进行研发，为推动半导体后工序的自动化与标准化作出贡献~

本公司株式会社 FUJI (公司总部：爱知县知立市、代表取缔役社长：五十棲 丈二、以下简称“FUJI”) 是半导体后工序自动化与标准化技术研究联盟 (简称“SATAS”，2024年4月成立) 的成员之一。在该联盟推进的半导体后工序自动化与标准化研发项目中，决定由本公司来负责定位精度要求极高的“裸芯片贴装工序 (Die Attach)” 的研发工作。

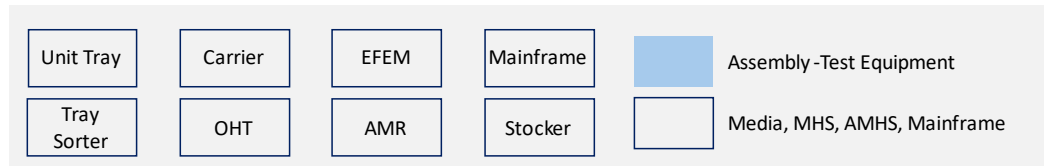
为此，将采用本公司的贴装机器人 (贴片机) ——“NXTR A 机型”去开展相关的研发工作。本公司将利用 NXTR 进行裸芯片贴装以及该工序的自动化技术的研发，从而为半导体后工序的自动化与标准化做出贡献。

用来生产评估板的设备与流程



上：计划采用的“NXTR A 机型”

右：在本项目中 FUJI 负责的部分
“裸芯片贴装工序” (Die Dip/Attach)



■ 需要高精度的裸芯片贴装工序

半导体封装在不断向更复杂、高密度化的方向发展。裸芯片贴装是左右下一代半导体封装的性能和可靠性的关键工序之一。近年来，随着芯粒技术不断被采用和三维贴装技术的发展，半导体制造业正在寻求更高的贴装精度和更稳定的工艺。

在本次合作中，FUJI 将负责高精度裸芯片贴装工序的研发工作。

■ 兼顾“高精度”与“自动化”的技术基础

本公司在 SMT 领域不断精心打磨高精度贴装技术，还自主研发了智能工厂，从而使物料供应在内的整线自动化运用已投入商业化应用。

本公司已确立了可以应对半导体后工序的“高精度”与“自动化”要求的技术基础。在这次的研发任务中，我们将充分利用这些技术基础。

■ 建立在标准机型这一基础上的实用性和可靠性

本次研发任务所使用的“NXTR A 机型”以标准机为基础，另外再有针对性地选择了一些选项。通过使用标准机型而非专用机型，可确保将来量产时的实用性和高可靠性。

FUJI 机器人应用事业本部 本部长 佐藤 武 寄语

这次，本公司在 SATAS 推出的研发项目中的负责部分已被正式确定。为了开展裸芯片贴装工序的研发工作，SATAS 已决定采用本公司的设备。这在日益复杂的半导体后工序中是需要更高贴装精度与稳定的自动化技术的领域。作为研发项目的一员，我们将把迄今为止研发的高精度贴装与自动化技术融合在一起，一步一个脚印地推进研发工作。

对未来的展望

今后，本公司将通过该项目不断积累半导体后工序领域的技术经验。为了能够应用到量产设备上，将进一步推进技术研发。同时，通过深化贴装技术与整线自动化技术的融合，为半导体制造领域的生产效率的提升与稳定运行做出贡献，并进一步强化公司的事业基础。

相关新闻

[June 19, 2025: NEDO announces decision on pilot line construction site and start of construction for "Post-5G Information and Communications System Infrastructure Strengthening Research and Development Project / Development of Advanced Semiconductor Manufacturing Technology / Research and Development on Development and Demonstration of Semiconductor Post-Process Automation and Standardization"](#)

半导体后工序自动化与标准化技术研究联盟 (SATAS)

半导体后工序自动化与标准化技术研究联盟 (SATAS) 成立于 2024 年 4 月，旨在推动半导体制造后工序（封装、组装和检查工序）的自动化与标准化。SATAS 着眼于对半导体生产的经济性影响巨大的后工序领域，推进省人化与自动化所必需的设备与系统之间的标准化，并进行原型机、商用机以及试产线的验证。SATAS 将进行后工序自动化所需关键技术的研发、开放式行业标准规范的制定、相关设备的研发与实装，并在集成的试产线上对设备进行验证。它以提升能源生产效率、减少废弃物排放为目标，力争在 2028 年以后实现商业化应用。本项目的研究成果和技术将陆续引进到现有的工厂及新建工厂。

SATAS 官方网站：<https://satas-cip.jp/en/>

公司概况

公司名称：株式会社 FUJI
法人代表：代表取缔役社长 五十棲 丈二
公司地址：爱知县知立市山町茶碓山 19 邮编：472-8686
成立时间：1959 年 4 月
事业内容：电子元件贴装机器人(贴片机)以及数控机床的研发、制造、销售
注册资金：58.78 亿日元
网站：<https://www.fuji.co.jp/cn/> (官方网站)
<https://smt.fuji.co.jp/cn/> (SMT 专用网站)

咨询窗口

株式会社 FUJI 机器人应用事业本部 (咨询页面)

<https://smt.fuji.co.jp/cn/contact/>